

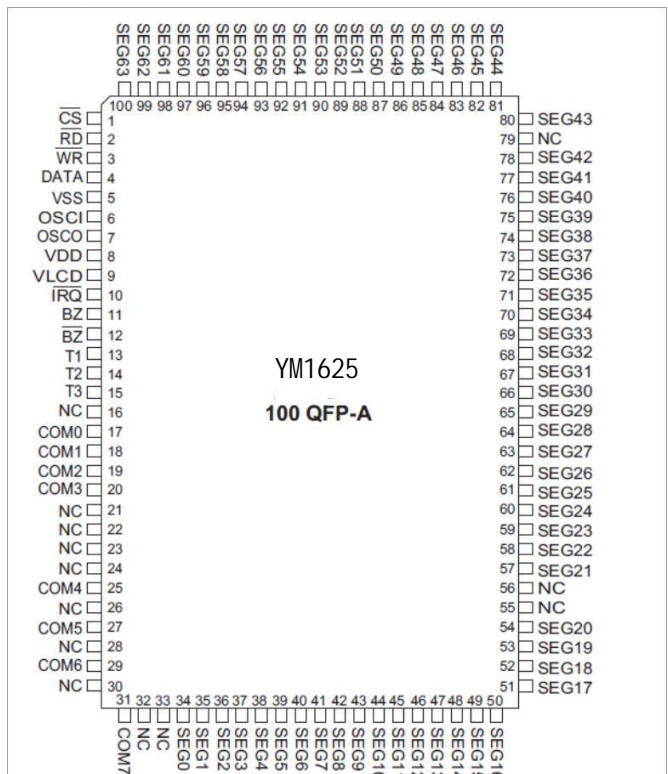
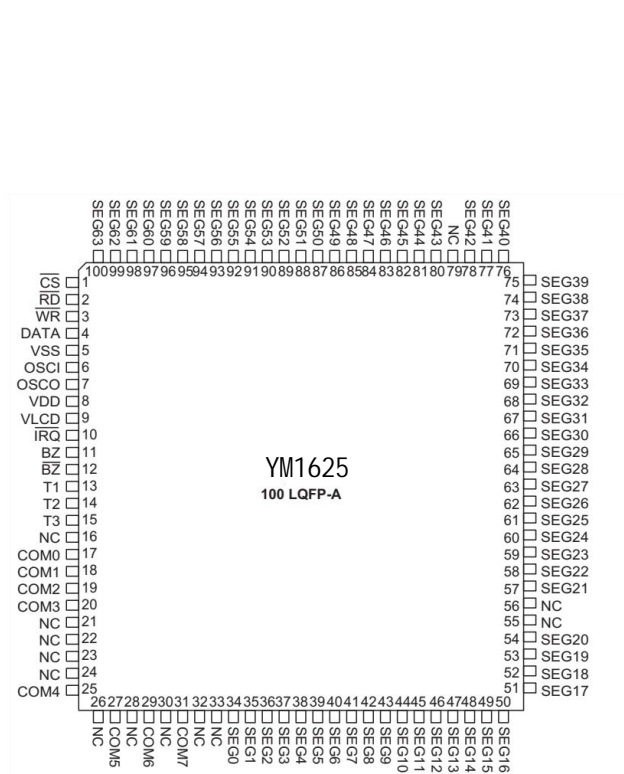
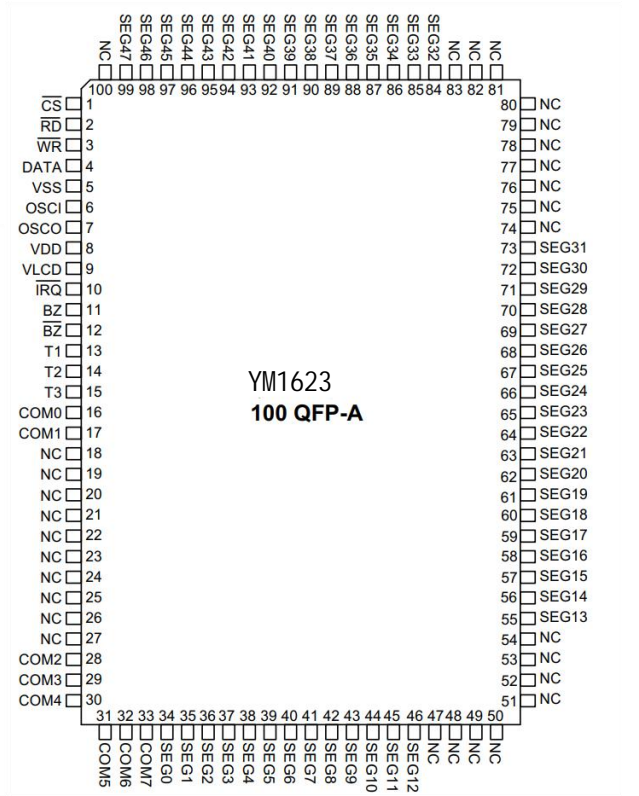
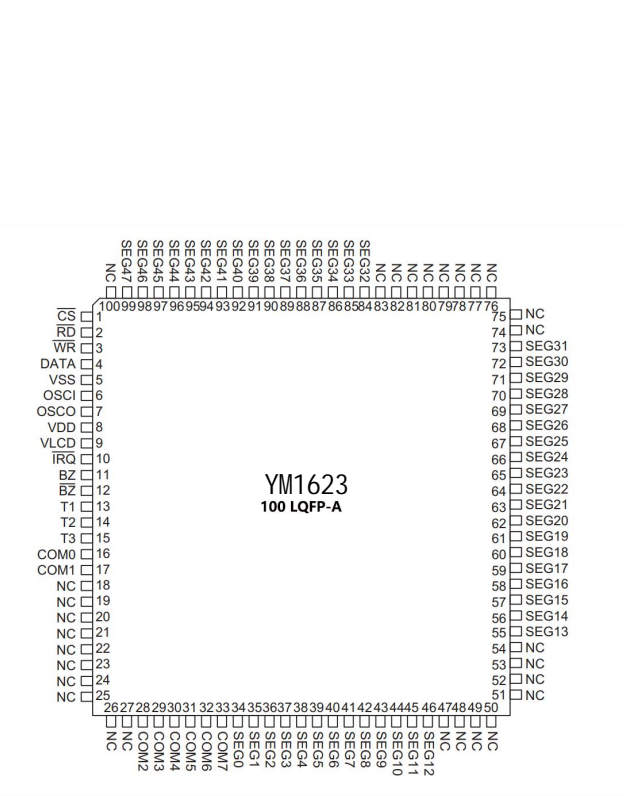
YM1623/YM1625 封装技术文件

1、芯片信息

序号	项 目	内 容	备注
1	产品名称	YM1623/YM1625	E001B
2	封装形式	100LQFP/QFP100	
3	PAD 数目	138	
4	打线数目	71/87	
5	芯片衬底电位	VDD	导电胶
6	圆片尺寸		
7	芯片面积	2870*2860um(含划槽)	划片槽(60um)
8	PAD 尺寸(um)	70*70	下面无图形
9	铝垫厚度(um)	1	铝垫尺寸(70um)
10	金丝直径(um)	20um	钎铜线
11	单片理论管芯数	1800PCS	
12	最大功耗 (mw)	1000	
13	最高工作频率 (HZ)	500K	
14	工作环境温度 (°C)	-40~85	
15	对外壳的其它特殊要求		
16	成品表面标识		

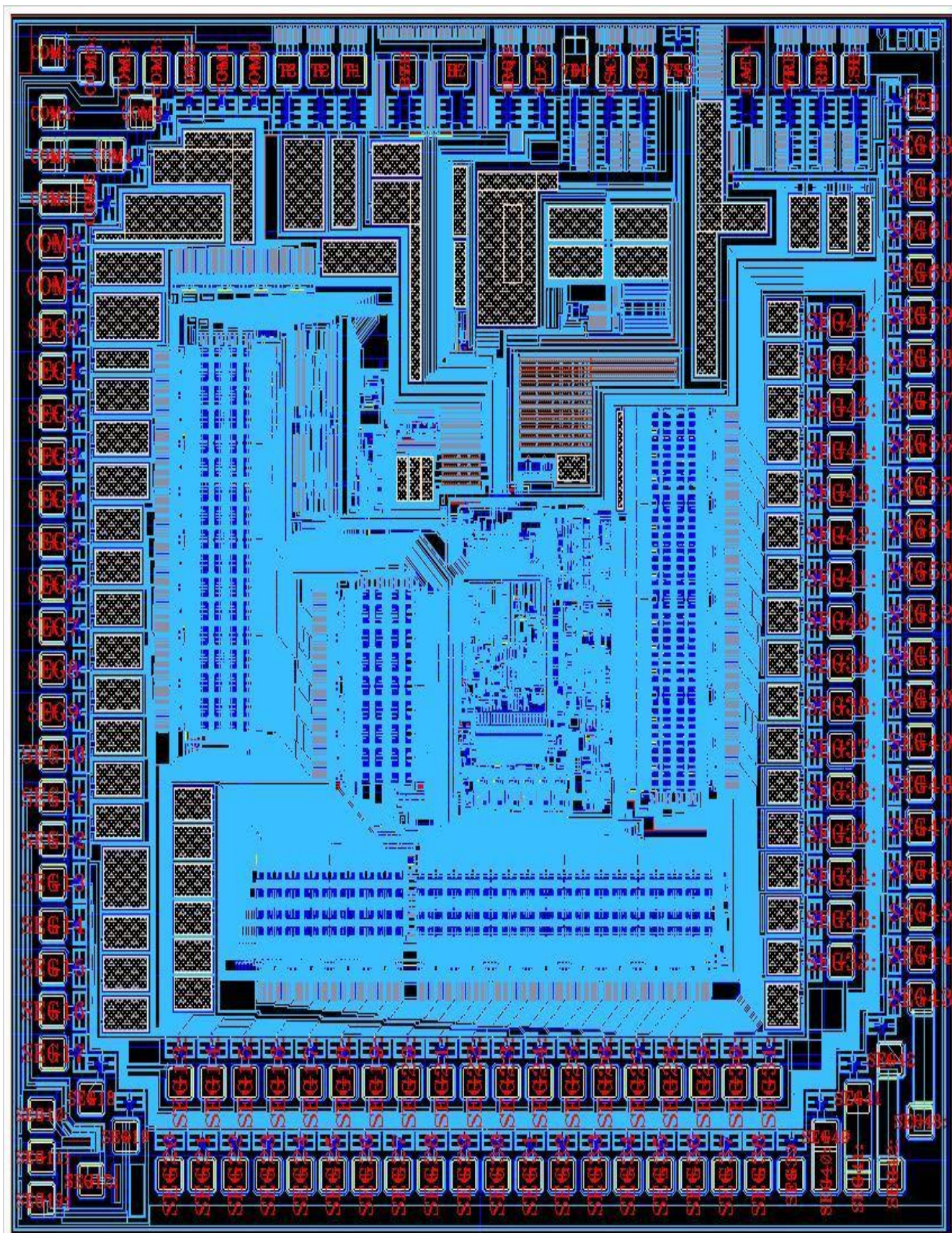
YM1623/YM1625 封装技术文件

2、封装脚位图



YM1623/YM1625 封装技术文件

3、概貌图

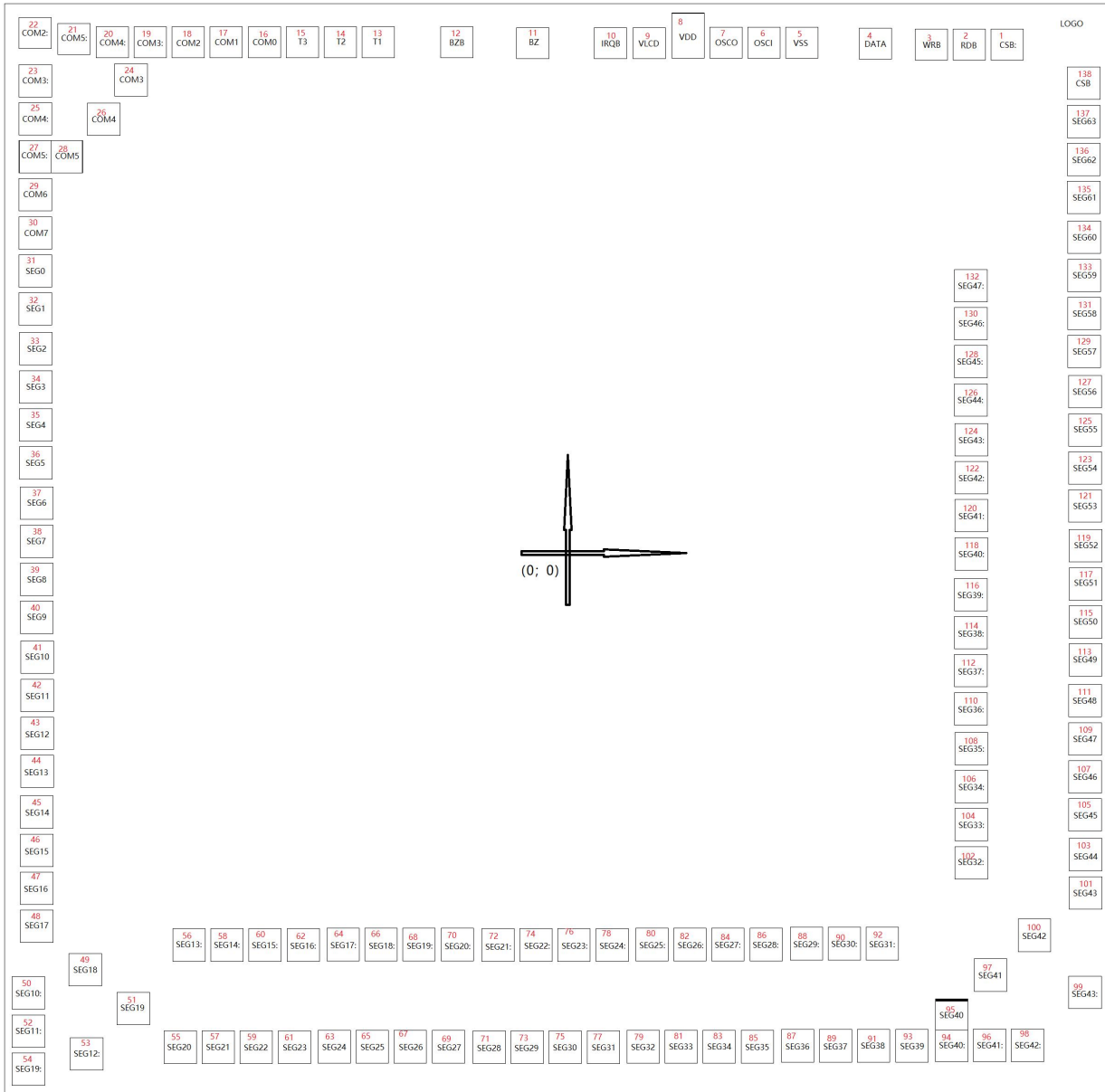


YM1623/YM1625

概貌图

YM1623/YM1625 封装技术文件

4、Pad 图



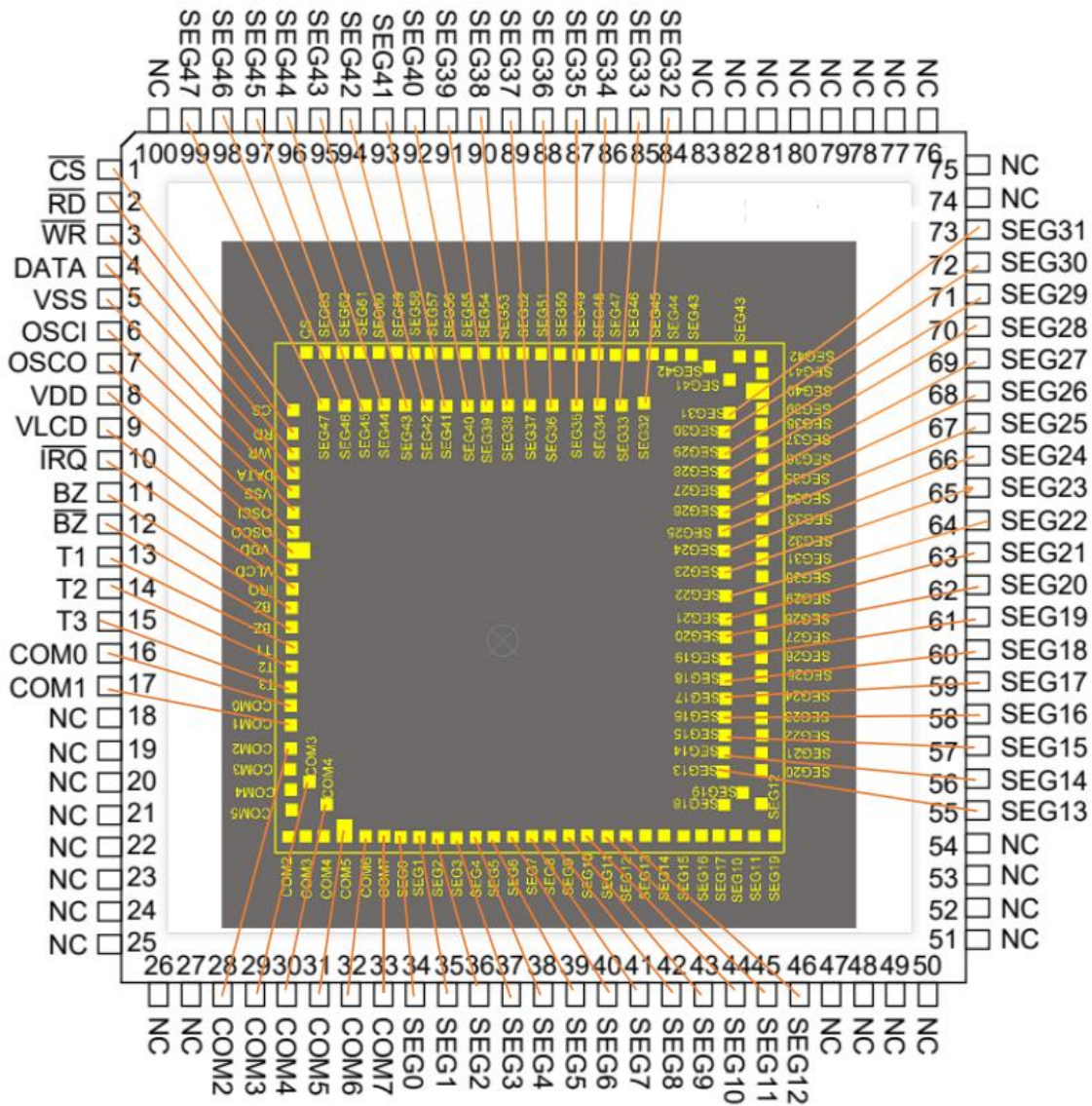
YM1623/YM1625 封装技术文件

E001B 脚位坐标值表

NO	NAME	X(um)	Y(um)	NO	NAME	X(um)	Y(um)	NO	NAME	X(um)	Y(um)
1	CSB:	1146	1302.2	47	SEG16	-1304.4	-902.8	93	SEG39	951.4	-1288.9
2	RDB	1044	1302.2	48	SEG17	-1304.4	-1002.8	94	SEG40:	1056.4	-1288.9
3	WRB	942	1302.2	49	SEG18	-1188.2	-1108.9	95	SEG40	1056.4	-1198.9
4	DATA	812.4	1302.2	50	SEG10:	-1338.2	-1147.8	96	SEG41:	1156.4	-1288.9
5	VSS	606.7	1302.2	51	SEG19	-1083.2	-1198.9	97	SEG41	1156.4	-1108.9
6	OSCI	496.7	1302.2	52	SEG11:	-1338.2	-1247.8	98	SEG42:	1256.4	-1288.9
7	OSCO	396.7	1302.2	53	SEG12:	-1188.2	-1302.9	99	SEG43:	1346.4	-1163.15
8	VDD	291.7	1302.2	54	SEG19:	-1338.2	-1347.8	100	SEG42	1256.4	-1018.9
9	VLCD	186.7	1302.2	55	SEG20	-948.6	-1288.9	101	SEG43	1346.4	-872.7
10	IRQB	86.7	1302.2	56	SEG13:	-917.6	-1072.2	102	SEG32:	1103.7	-788.8
11	BZ	-71.6	1302.2	57	SEG21	-848.6	-1288.9	103	SEG44	1346.4	-772.7
12	BZB	-229.9	1302.2	58	SEG14:	-817.6	-1072.2	104	SEG33:	1103.7	-688.8
13	T1	-388.2	1302.2	59	SEG22	-748.6	-1288.9	105	SEG45	1346.4	-672.7
14	T2	-488.2	1302.2	60	SEG15:	-717.6	-1072.2	106	SEG34:	1103.7	-588.8
15	T3	-588.2	1302.2	61	SEG23	-648.6	-1288.9	107	SEG46	1346.4	-572.7
16	COM0	-688.2	1302.2	62	SEG16:	-617.6	-1072.2	108	SEG35:	1103.7	-488.8
17	COM1	-788.2	1302.2	63	SEG24	-548.6	-1288.9	109	SEG47	1346.4	-472.7
18	COM2	-888.2	1302.2	64	SEG17:	-517.6	-1072.2	110	SEG36:	1103.7	-388.8
19	COM3:	-988.2	1302.2	65	SEG25	-448.6	-1288.9	111	SEG48	1346.4	-372.7
20	COM4:	-1088.2	1302.2	66	SEG18:	-417.6	-1072.2	112	SEG37:	1103.7	-288.8
21	COM5:	-1188.2	1310.6	67	SEG26	-348.6	-1288.9	113	SEG49	1346.4	-272.7
22	COM2:	-1304.45	1345.2	68	SEG19:	-317.6	-1072.2	114	SEG38:	1103.7	-188.8
23	COM3:	-1304.4	1202.2	69	SEG27	-248.6	-1288.9	115	SEG50	1346.4	-172.7
24	COM3	-1034.3	1202.2	70	SEG20:	-217.6	-1072.2	116	SEG39:	1103.7	-88.8
25	COM4:	-1304.4	1102.2	71	SEG28	-148.6	-1288.9	117	SEG51	1346.4	-72.7
26	COM4	-1124.4	1102.2	72	SEG21:	-117.6	-1072.2	118	SEG40:	1103.7	11.2
27	COM5:	-1304.4	1002.2	73	SEG29	-48.6	-1288.9	119	SEG52	1346.4	27.3
28	COM5	-1214.4	1002.2	74	SEG22:	-17.6	-1072.2	120	SEG41:	1103.7	111.2
29	COM6	-1304.4	897.2	75	SEG30	51.4	-1288.9	121	SEG53	1346.4	127.3
30	COM7	-1304.4	797.2	76	SEG23:	82.4	-1072.2	122	SEG42:	1103.7	211.2
31	SEG0	-1304.4	697.2	77	SEG31	151.4	-1288.9	123	SEG54	1346.4	227.3
32	SEG1	-1304.4	597.2	78	SEG24:	182.4	-1072.2	124	SEG43:	1103.7	311.2
33	SEG2	-1304.4	497.2	79	SEG32	251.4	-1288.9	125	SEG55	1346.4	327.3
34	SEG3	-1304.4	397.2	80	SEG25:	282.4	-1072.2	126	SEG44:	1103.7	411.2
35	SEG4	-1304.4	297.2	81	SEG33	351.4	-1288.9	127	SEG56	1346.4	427.3
36	SEG5	-1304.4	197.2	82	SEG26:	382.4	-1072.2	128	SEG45:	1103.7	511.2
37	SEG6	-1304.4	97.2	83	SEG34	451.4	-1288.9	129	SEG57	1346.4	527.3
38	SEG7	-1304.4	-2.8	84	SEG27:	482.4	-1072.2	130	SEG46:	1103.7	611.2
39	SEG8	-1304.4	-102.8	85	SEG35	551.4	-1288.9	131	SEG58	1346.4	627.3
40	SEG9	-1304.4	-202.8	86	SEG28:	582.4	-1072.2	132	SEG47:	1103.7	711.2
41	SEG10	-1304.4	-302.8	87	SEG36	651.4	-1288.9	133	SEG59	1346.4	727.3
42	SEG11	-1304.4	-402.8	88	SEG29:	682.4	-1072.2	134	SEG60	1346.4	827.3
43	SEG12	-1304.4	-502.8	89	SEG37	751.4	-1288.9	135	SEG61	1346.4	927.3

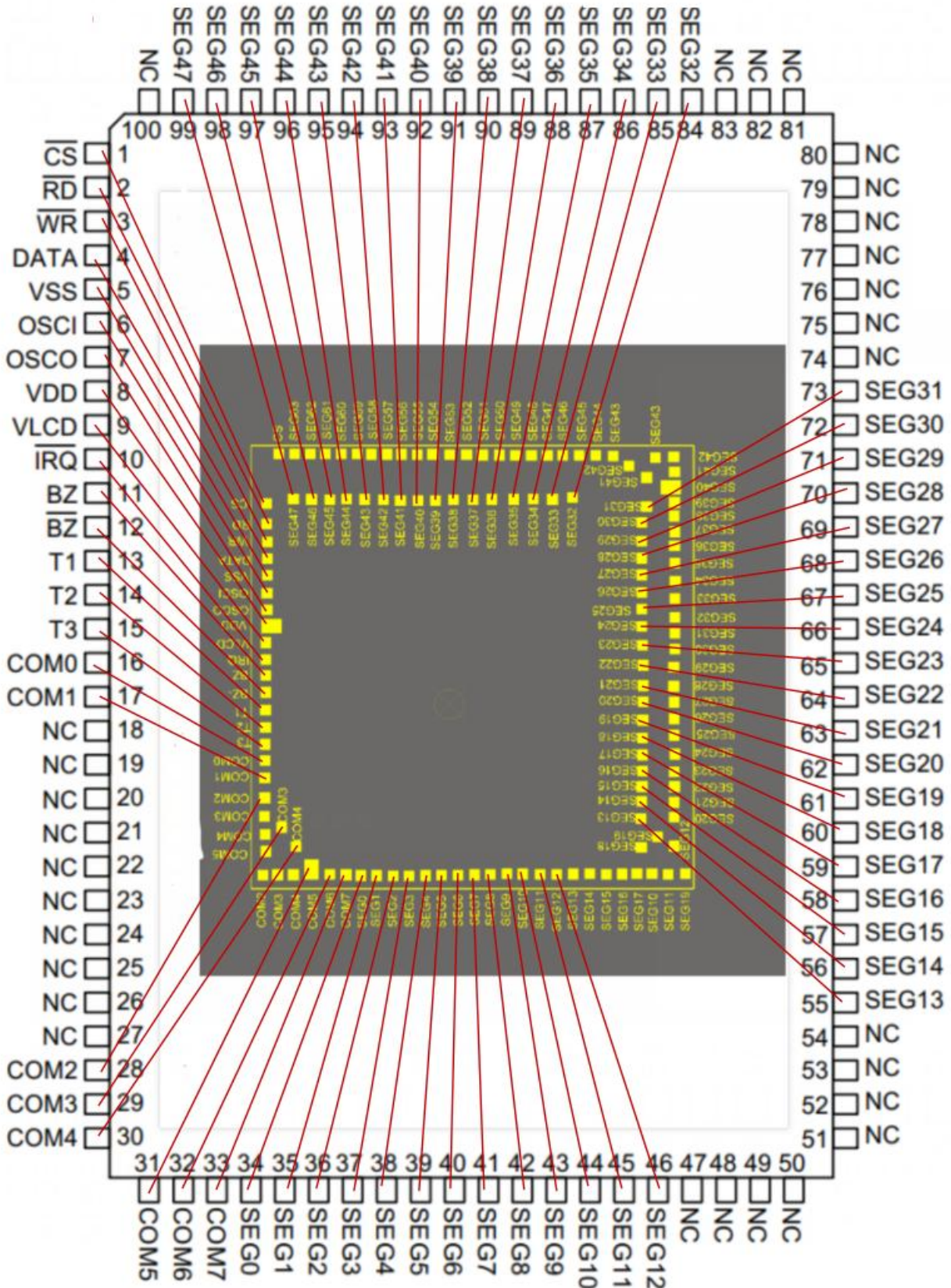
44	SEG13	-1304.4	-602.8	90	SEG30:	782.4	-1072.2	136	SEG62	1346.4	1027.3
45	SEG14	-1304.4	-702.8	91	SEG38	851.4	-1288.9	137	SEG63	1346.4	1127.3
46	SEG15	-1304.4	-802.8	92	SEG31:	882.4	-1072.2	138	CSB	1346.4	1227.3

5、YM1623, LQFP100 封装打线示意图



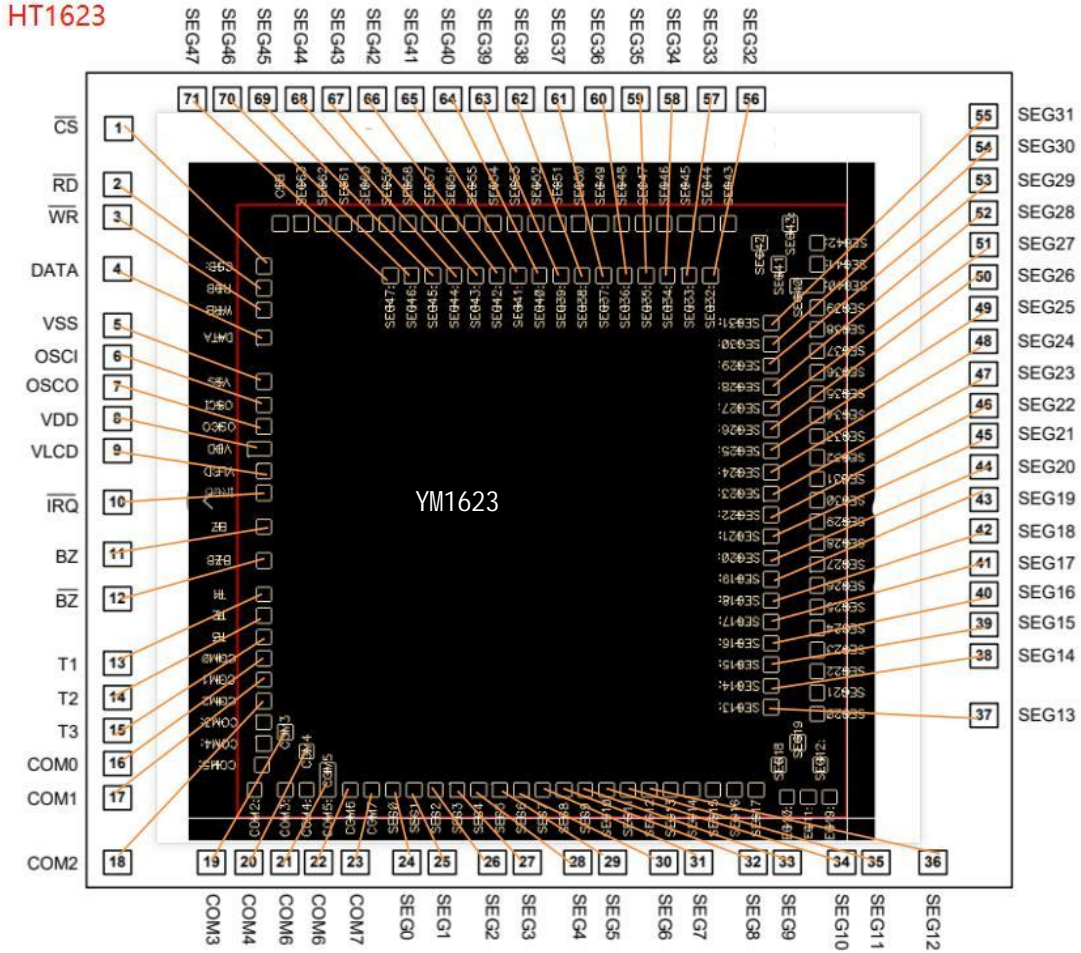
YM1623/YM1625 封装技术文件

YM1623, QFP100 封装打线示意图



YM1623/YM1625 封装技术文件

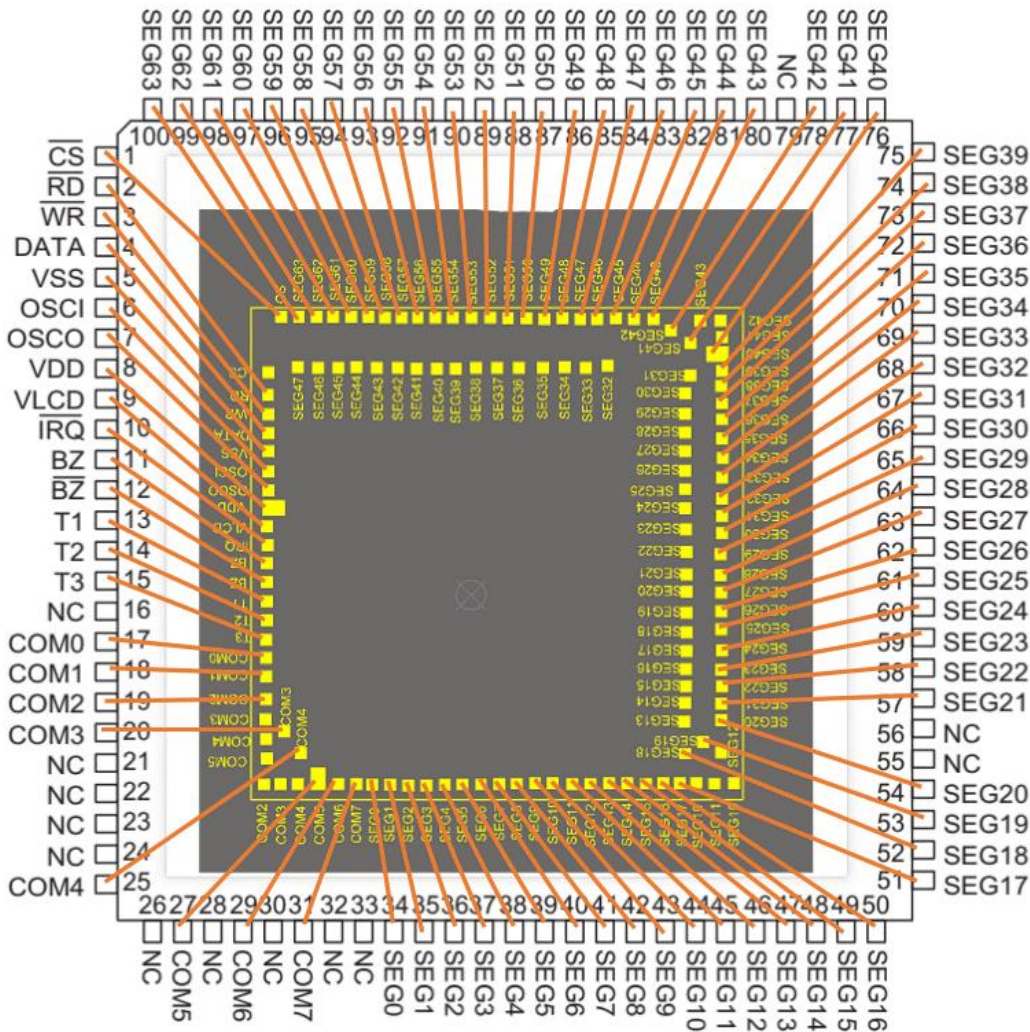
YM1623 绑定(COB)示意图。



Dice 绑定片衬底接 VDD 或者悬空，但是不能接 GND。

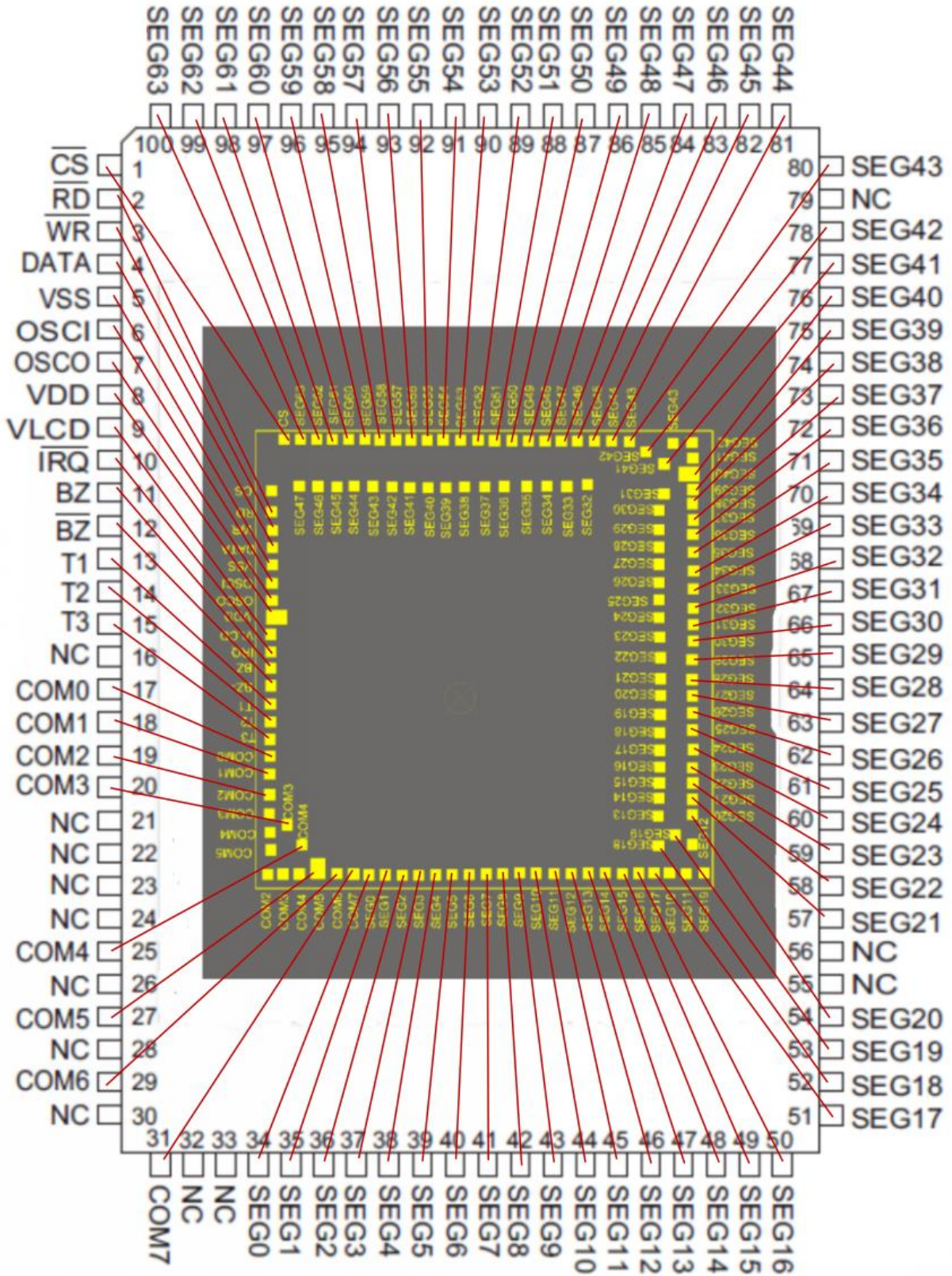
YM1623/YM1625 封装技术文件

5、YM1625 、100LQFP 封装打线示意图



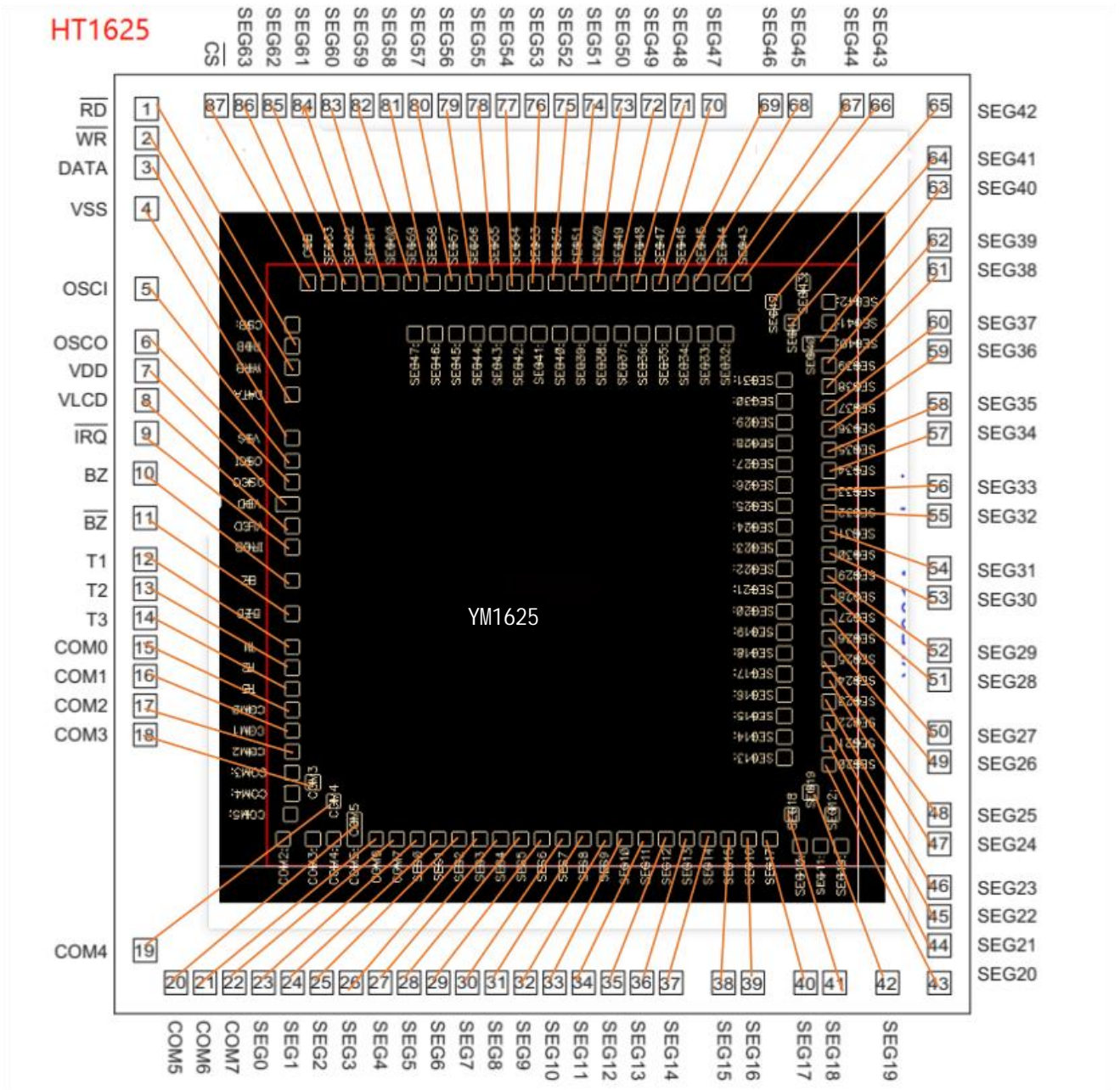
YM1623/YM1625 封装技术文件

6、YM1625 、100QFP 封装打线示意图



YM1623/YM1625 封装技术文件

7、YM1625 绑定 (COB) 示意图



Dice 绑定片衬底接 VDD 或者悬空，但是不能接 GND。